

# Thermal Interface Material

## Thermal Tape

### Geringer Wärmewiderstand und hohe Wärmeleitfähigkeit

Low heat resistance and high thermal conductivity

### Stanzteil nach Zeichnung

Stamped parts according to drawing

### Zur Befestigung von elektronischen Bauteilen und Radiatoren

For fixing electronic components and radiators.

Materialstärke  
Material thickness  
1.00 = 1.00 mm

DS-TAP-P-A2-1.2-**X.XX**

## DS-TAP-P-A2-1.2

Wärmeleitfähigkeit <sup>1</sup> Thermal Conductivity <sup>1</sup>	W/mK	1.20
Einsatztemperatur Operation Temperature	°C	-20 / +120
Materialstärke Material Thickness	mm	0.10   0.25   0.50
Durchschlagsfestigkeit <sup>2</sup> Dielectric Strength <sup>2</sup>	kV	2.50   6.00   6.00
Haftfestigkeit (180°) Peel Strength (180°)	N/25mm	13.00
Konformität Conformity	√	RoHS
Verstärkung Reinforced Layer	√	Yes
Material Basis Material Base	-	Modifiziertes Acrylat (modified acrylate)

<sup>1</sup> ASTM D22470 <sup>2</sup> ASTM D149

REV2017\_01

Technische Änderungen vorbehalten, alle technischen Daten und Angaben unverbindlich.  
Subject to technical alterations, all technical data and details are not binding.